

臺灣新北地方法院民事判決

108年度簡上字第63號

上訴人 大禧工業股份有限公司

法定代理人 林寶玉

訴訟代理人 李俊昇

陳冠宇

被上訴人 全合精密股份有限公司

法定代理人 陳菊秀

訴訟代理人 王瑞雷

上列當事人間請求給付代工費事件，上訴人對於中華民國107年12月28日本院三重簡易庭107年度重簡字第906號第一審判決提起上訴，經本院於108年12月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人主張：上訴人於民國105年間將其廠內料號032-4H G0025A02電路板（下稱系爭032電路板）、廠內料號093-4N F0003C04電路板（下稱系爭093電路板）交由被上訴人承攬壓合加工工作，被上訴人均已依約完成並交付工作，然上訴人無故扣款，尚有承攬代工款新臺幣（下同）267,940元未給付，經被上訴人屢次催討，仍未獲置理。爰依承攬之法律關係，依民法第490條第1項、第505條第1項規定，請求上訴人給付267,940元，及自支付命令繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息等語。

二、上訴人則以：被上訴人完成壓合加工之系爭032電路板，於上訴人出貨予客戶上件時，其中101片因發生PP層分層之爆板現象而遭報廢，上訴人因此受有損失208,055元，而PP膠片係於電路板（PCB）製造流程中之壓合製程所製作，且分層均發生在PP膠片與基板黏合處，顯示PP膠片結合力不佳，才會導致客戶上件時因高溫而產生爆板現象，復經烘烤125度6小時除去板面濕氣，而摒除外在因素後，測試爆板分層

，仍分層在PP層，而未分層在板內Core層，顯示被上訴人於壓合PP膠片過程中有異常；另被上訴人完成壓合加工之系爭093 電路板，於上訴人進料檢驗時，發現其中138 片之介質層厚度僅為11.968-12.687mil，因不符上訴人於生產工作單所要求介質層厚度應達13.03-15.39mil之規格而遭報廢，上訴人因此受有損失59,885元，是被上訴人承攬系爭032 電路板、系爭093 電路板之壓合加工工作既有前述瑕疵，爰依民法第495 條第1 項規定，請求減少承攬報酬267,940 元等語置辯。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決，判命上訴人給付267,940 元，及自107 年4 月10日起至清償日止，按年息5 %計算之利息，上訴人提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人於第一審之訴駁回。被上訴人則聲明：上訴駁回。

四、兩造不爭執之事實（見本院卷二第40頁至第41頁）：

(一)兩造間成立由被上訴人為上訴人完成系爭032 電路板、系爭093 電路板之壓合加工工作，上訴人俟被上訴人工作完成後，給付報酬之承攬契約。

(二)被上訴人完成系爭032 電路板、系爭093 電路板之壓合加工工作並交付予上訴人後，上訴人尚有承攬報酬267,940 元未給付。

(三)系爭032 電路板於上訴人出貨予其客戶上件後，其中101 片電路板因發生爆板分層現象而遭報廢，上訴人因此受有損失208,055 元。

(四)經上訴人出貨並已上件之系爭032 電路板經南亞CCL 技術處鑑定結果如原審卷第87頁，同原審卷第109 頁。

(五)系爭093 電路板經上訴人切片檢驗，其中138 片電路板因發現介質層厚度為11.968-12.687mil而遭報廢，上訴人因此受有損失59,885元。

五、得心證之理由：

本件兩造所爭執之處厥為系爭032 電路板之爆板分層現象，是否為被上訴人承攬壓合加工工作過程中所發生之瑕疵？兩

01 造間就系爭093 電路板所成立之承攬契約，有無約定被上訴
02 人完成壓合加工之介質層厚度應具備13.03-15.39mil之規格
03 ？上訴人請求減少承攬報酬有無理由？被上訴人請求上訴人
04 給付承攬報酬有無理由？茲分述如下：

05 (一)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
06 民事訴訟法第277條第1項定有明文。又因可歸責於承攬人
07 之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依前2條之規定，請
08 求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償
09 ，民法第495條第1項亦有明文。本件上訴人以被上訴人承
10 攬之工作有瑕疵為由，請求減少報酬，自應由上訴人就被上
11 訴人承攬之工作有瑕疵之事實，負舉證責任。

12 (二)系爭032 電路板之爆板分層現象，是否為被上訴人承攬壓合
13 加工工作過程中所發生之瑕疵？

14 1.本件上訴人抗辯系爭032 電路板之爆板分層現象係被上訴人
15 承攬壓合加工工作過程中所發生之瑕疵，既為被上訴人所爭
16 執，依前揭舉證責任分配之原則，自應由上訴人就此負舉證
17 之責。

18 2.系爭032 電路板經被上訴人委由南亞CCL技術處鑑定結果為
19 「a 外觀觀察，雙面上件，分層於板邊固定孔旁局部線路零
20 件處。b 切片分析，分層發生於2116HRPP樹脂與黑化線路空
21 曠區接合處分離。c DSC分析，上件板未經處理時，Delta
22 Tg=9.47℃，Delta Tg大於5℃。經Banking105℃x 2hrs，
23 Delt a Tg =4.12℃，Delta Tg縮小於5℃；其上件板烘烤
24 後，Tg 1特性提升及縮短△Tg差異，板材嚴重吸濕。d 材料
25 耐熱性分析結果，T-260優於一般HF材料水準。e 由IMC觀
26 察，上件板之IMC厚度大於8 μm以上（最大13.66 μm）
27 。f 以上分析，研判板材嚴重吸濕及上件熱履歷，造成組裝
28 上件分層」等節，有鑑定結果可稽（見原審卷第87頁），兩
29 造對此鑑定結果均不爭執，自堪信為真實。

30 3.上訴人自陳在被上訴人完成系爭032 電路板之壓合加工工作
31 並交付予上訴人後，系爭032 電路板尚需進行鑽孔/鑽靶、

01 撈邊 / 磨邊、PTH、磨刷 / 去膠、化學鍍銅、鍍一次銅、外
02 層線路製作、鍍第二次銅、鍍錫鉛、去膜 / 蝕刻 / 剝錫、防
03 焊、文字印刷、表面加工、成型、短斷路測試 / 防抗測試、
04 成品檢驗、真空包裝等製程並經上訴人入庫後，再出貨予客
05 戶等語（見本院卷二第32頁至第33頁），復有上訴人提出之
06 PCB製造流程圖可查（見原審卷第167頁），足見系爭032
07 電路板於被上訴人完成壓合加工工作後，仍需逐一完成前開
08 後續製程並經上訴人入庫後，最終始出貨予上訴人之客戶上
09 件，而依證人即南亞CCL技術處鑑定人員雷中峯於原審審理
10 中證述：我負責鑑定造成系爭032電路板爆板分層現象之原
11 因，以DSC儀器就2個條件分析，第一個條件是電路板未烘
12 烤前Delta微分曲線的差異，2條曲線差5度以上，代表有
13 吸水現象，第二個條件是烘烤後將水氣去除，微分曲線在5
14 度以內，代表有吸水現象，此現象係因水蒸氣蒸發掉，使電
15 路板有分層現象，爆板分層現象在熱製程階段會產生，壓合
16 階段若未將水氣壓掉，也會產生爆板分層現象，但系爭電
17 路板爆板現象是發生在上件時，已無法測試壓合階段有無吸
18 水現象，若欲測試壓合階段有無吸水現象，必須於電路板上
19 件前測試等情（見原審卷第197頁至第198頁），可知因系
20 爭032電路板係於被上訴人完成壓合加工工作並交付予上訴
21 人後，復經逐一完成前開後續製程並經上訴人入庫後，最後
22 出貨予上訴人之客戶上件時，始發生爆板分層現象，故無法
23 判定系爭032電路板之爆板分層現象是否係於被上訴人承攬
24 壓合加工工作過程中所產生，且在壓合加工階段後之熱製程
25 階段亦可能會產生電路板爆板分層現象，不能排除系爭032
26 電路板之爆板分層現象係於後續熱製程階段所產生之可能性
27 ，上訴人復未舉證證明系爭032電路板之爆板分層現象係發
28 生於被上訴人承攬之壓合加工階段，自無從逕認系爭032電
29 路板之爆板分層現象即係被上訴人承攬壓合加工工作過程中
30 所發生之瑕疵，是上訴人就此抗辯，自無可採。

31 (二)兩造間就系爭093電路板所成立之承攬契約，有無約定被上

01 訴人完成壓合加工之介質層厚度應具備13.03-15.39mil之規
02 格？

03 本件上訴人抗辯兩造間就系爭093 電路板成立之承攬契約有
04 約定被上訴人完成壓合加工之介質層厚度應具備13.03-15.3
05 9 mil 之規格，既為被上訴人所爭執，依前揭舉證責任分配
06 之原則，自應由上訴人就此負舉證之責。查上訴人就此抗辯
07 雖提出第2頁載有「介質層厚度：13.03-15.39mil」一節之
08 生產工作單為證（見原審卷第183頁至第184頁），惟被上
09 訴人既爭執上訴人交由被上訴人承攬系爭093 電路板之壓合
10 加工工作時，僅以傳真方式指示應具備該生產工作單第1頁
11 所示之規格，而未指示該生產工作單第2頁所示之介質層厚
12 度規格，並據被上訴人提出該生產工作單第1頁之傳真為證
13 （見原審卷第185頁），自應由上訴人先舉證證明其交由被
14 上訴人承攬系爭093 電路板之壓合加工工作時，確有與被上
15 訴人約定應具備該生產工作單第2頁所示之介質層厚度規格
16 ，然上訴人既未能就此舉證以實其說，自無從驟認兩造間就
17 系爭093 電路板成立之承攬契約有約定被上訴人完成壓合加
18 工之介質層厚度應具備13.03-15.39mil之規格，是縱被上訴
19 人完成壓合加工之系爭093 電路板，經上訴人切片檢驗，發
20 現介質層厚度僅為11.968-12.687mil，仍不能認為有何不具
21 備約定規格之瑕疵，是上訴人就此抗辯，洵無可取。

22 (三)上訴人請求減少承攬報酬有無理由？

23 系爭032 電路板之爆板分層現象既非上訴人承攬壓合加工工
24 作過程中所發生之瑕疵，且系爭093 電路板亦無不具備約定
25 規格之瑕疵，則上訴人以被上訴人承攬之工作有瑕疵為由，
26 請求減少承攬報酬，殊非有據。

27 (四)被上訴人請求給付承攬報酬有無理由？

28 按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，
29 他方俟工作完成，給付報酬之契約。報酬應於工作交付時給
30 付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條
31 第1項、第505條第1項分別定有明文。查被上訴人承攬系

爭032 電路板、系爭093 電路板之壓合加工工作，均已完成並交付工作，但上訴人仍有承攬報酬267,940元未給付，為兩造所不爭執，而上訴人以被上訴人承攬之工作有瑕疵為由，請求減少承攬報酬，既無理由，則被上訴人依承攬之法律關係，請求上訴人給付尚欠之承攬報酬及自支付命令繕本送達即107年4月9日（見107年度司促字第8536號卷第17頁本院送達證書）翌日即107年4月10日起算之法定遲延利息，自屬有據。

六、綜上所述，被上訴人本於承攬之法律關係，請求上訴人給付267,940元，及自107年4月10日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。原審判令上訴人如數給付，並無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經審酌後與判決之結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中	華	民	國	109	年	1	月	15	日
				民	事	第	五	庭	審
					判	長	法	官	許
							法	官	瑞
							法	官	東
									王
									雅
									婷
									陳
									佳
									君

以上正本係照原本作成。

本判決不得上訴。

中	華	民	國	109	年	1	月	15	日
						書	記	官	李
									育
									真